



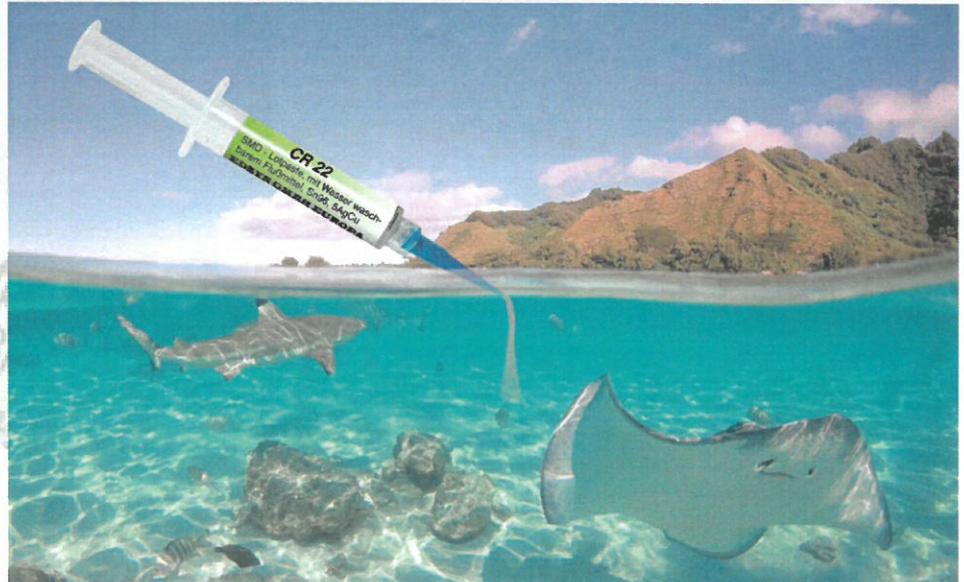
## Löten von SMT-Bauteilen / Soldering SMDs

### Lotpaste CR 22 / CR 22 Solder paste

**Bleifreies Löten mit 3 Metallen - mit wasserlöslichem Flußmittel ermöglicht eine einfache Reinigung ohne Erweiterung der Chemie auf der Leiterplatte**

**Leadfree soldering with 3 metals - with water soluble flux allows an easy cleaning without additional chemical substitutes in the PCB**

**wasserlöslich  
water soluble**



#### Verbrauchshinweise:

Nach der Entnahme der Paste muß die Spritze wieder möglichst dicht verschlossen werden. Benutzte Paste sollte nicht mit der frischen zusammen in einem Behälter aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozeß können diese selbstverständlich zusammen verwendet werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen dürfen allerdings nicht vermischt werden.

#### Vorteile:

- \* wasserlösliche Paste, ohne Halogenanteil
- \* biologisch abbaubar
- \* hervorragende Konturenstabilität
- \* einfacheres Löten von bleifreien Lötstellen im Vergleich zum Verarbeiten von bleifreiem Lötendraht
- \* keine Lotkugel- oder Spritzerbildung
- \* langzeitige Verarbeitung und lange Lagerzeit möglich
- \* hervorragend geeignet für Fine-Pitch-Anwendungen
- \* einwandfreie Lötresultate beim Einsatz mit Heißluft und LötKolben
- \* verschiedene Größen von konischen Dosier-nadeln (Option)

#### Instructions for use:

After taking out solder paste always close the syringe as tightly as possible. Used and new solder paste can be applied together, but should not be stored in the same container. Do not mix different solder alloys and types of paste.

#### Advantages:

- \* water soluble paste without halogen
- \* biodegradable
- \* superior definition
- \* easy soldering of lead-free soldering joints in comparison to lead-free soldering wire
- \* no globule or spatter formation
- \* long storage and useful life
- \* excellent suitability for fine pitch applications
- \* perfect soldering results with hot air tools and soldering irons
- \* conical dosing needles in various sizes



## Löten von SMT-Bauteilen / Soldering SMDs

### Lotpaste CR 22 / CR 22 Solder paste

**Bleifreies Löten mit 3 Metallen - mit wasserlöslichem Flußmittel ermöglicht eine einfache Reinigung ohne Erweiterung der Chemie auf der Leiterplatte**

**Leadfree soldering with 3 metals - with water soluble flux allows an easy cleaning without additional chemical substitutes in the PCB**

**wasserlöslich  
water soluble**



Unsere Lotpaste CR 22 ist für alle SMD-Anwendungen bestens geeignet. Das ansonsten langwierige Einlöten von SMT-Bauteilen mit bleifreiem Lötendraht wird durch den Einsatz der bleifreien Lotpaste CR 22 zu einem einfachen und schnellen Arbeitsgang.

Ihrer Entwicklung liegt nicht nur langjährige Erfahrung auf dem SMD-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, SN-, IPC- und MIL-Normen zugrunde.

Die Flußmittelzusammensetzung entspricht **F-SW 33** oder nach den neuen Normen **RE L0**. Hierbei handelt es sich um ein wasserlösliches Flußmittel, dessen Rückstände einfach nach dem Löten mit Wasser entfernt werden. Zusätzliche chemische Materialien auf der Leiterplatte werden nicht benötigt. Die Rückstände sollten immer entfernt werden.

Die bleifreie Lotlegierung enthält **Sn 96,5 Ag Cu 0,5**

#### Qualifikation:

Die Lotpaste CR 22 ist eine wasserlösliche Paste, die den höchsten Anforderungen entspricht.

Die entsprechenden Korrosions-, Lotkugel- und Benetzungstests wurden ebenso wie die Konturenstabilitätsprüfung bestanden. Die Rückstände müssen von der Leiterplatte entfernt werden.

#### Lagerung:

Das ungeöffnete Gebinde kann bei einer Lagerung von 20°C Raumtemperatur 6 Monate gelagert werden. Im geöffneten Zustand ist die maximale Verarbeitungszeit von den Umwelteinflüssen abhängig.

Our lead-free solder paste CR 22 is excellent suitability for all SMD applications. CR 22 makes soldering of SMT components an easy and quick process, especially in comparison with lead-free soldering wire.

CR 22 is the essence of years of experience in the field of SMD applications and was developed to fully and strictly comply with DIN, SN, IPC and MIL standards.

The flux composition complies with **F-SW 33** or according to the new restrictions **RE L0**. The flux is water soluble. Possible flux residues can be cleaned easy with water after the soldering process. The flux residues have to be removed

The lead-free solder alloy itself is composed as follows:

**Sn 96,5 Ag Cu 0,5**

#### Qualifikation:

CR 22 solder paste is an water soluble paste which meets high requirements.

CR 22 passed all corrosion, wetting and globule solderability tests under this standard. The residues have to be removed from the PCB.

#### Storage:

The unopened package has a storage life of 6 months at a room temperature of 20°C. Once opened, the maximum useful life depends on the